

# **EVG®150**

## 全自動レジスト プロセス装置



### イントロダクション

最大200 mm径のウェーハに対応するEVG<sup>®</sup>150は、高いスループットを実現する全自動レジストプロセス装置です。

完全モジュール型プラットフォームとして設計されたEVG150は、スピン/スプレー/現像プロセスでの高スループットを実現します。フットプリント3 m²以下のコンパクト設計とモジュール設計の見直しにより、ロボットエリアだけでなく、各チャンバーへのアクセスも容易になりました。 メンテナンスによるダウンタイムを最小限に抑えるために、装置内の他の部分を稼働させたまま、一部のモジュールだけを修理することが可能です。 この装置は、4台のウェット処理モジュールと最大20台のベーク/冷却ユニットを搭載しています。 高速で、高精度のロボットと高度なスケジューラアルゴリズムにより、実プロセスでの卓越したスループット値を実現します。 非常にコンパクトな設計でありながら、本体フレーム内に最大12台のポンプとレジストボトルを設置することができます。 EVG150は、要件の厳しい厚膜レジスト・アプリケーションからサブミクロン層まで、均一性の高い塗布処理を保証します。 従来のスピン塗布方式では限界のあった高段差形状 への塗布も、EVG独自の超音波霧化技術であるOmniSpray技術によって可能となりました。 XYスプレー塗布モジュールは最大4台まで搭載することができ、比類のないスループットを実現します。 これら、多機能モジュールの多彩な組み合わせにより、MEMS、イメージセンサー、先端パッケージング、RF、5G、3Dセンシング、フォトニクス、自動車、パワーエレクトロニクス製造などの数多くの応用分野で大きな可能性を提供します。

#### | | テクニカルデータ

ウェーハ径(基板サイズ)	200 mmまで
利用可能なモジュール	- スピン塗布 / OmniSpray® / 現像
	- ベーク / 冷却 / 蒸気プライム
ウェーハ搬送オプション	- デュアル・エンドエフェクター / エッジ搬送
	- ゆがみ・反り・薄ウェーハの搬送
ディスペンスオプション	- 52000 cPまでの幅広い粘度に対応する各種レジス
	ト・ディスペンス・ポンプ
	- 定圧ディスペンサ・システム
	- EBR / BSR / プリウエット / 液中プライミング

## お問い合わせ

イーヴィグループジャパン株式会社 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパークイーストタワー1F

Sales@EVGroup.jp

+81 45 348 0665



## 特長

- 200 mmまでの基板サイズに対応
- 組み合わせ自由な4つのウェット処理モジュール
- ツール内に最大20枚のホット/チル プレートをスタック可能
- 2基または4基のロードポート。SEMI S8エルゴノミクス規格に 完全準拠したカセットステーション
- 密閉型チャンバーでクロスコンタミネーションを防止
- プロセスモジュール筐体内部での レジスト・薬液ライン: ポンプから 吐出口までを最短距離で供給
- 最高のスループットを実現する洗練 されたロボットハンドリング;配置 精度は50 μm以下
- 厚ウェーハ、極薄ウェーハ、壊れやすいウェーハや反りウェーハ、小径のウェーハ搬送も可能
- スピン塗布用高精度流量計を備えた柔軟な圧力ディスペンス・システム;最大1ガロンまでのボトルサイズ対応
- レジスト・現像液ラインの温度を完全制御
- OmniSpray®: 極端な形状のコンフォーマル塗布;モジュールあたり最大2つのノズル
- 250 °Cまでの全温度範囲において、均一性 <± 0.4 %を実現するベークモジュール
- オプション:両面加熱によるソルベントベーク、最高350°Cの高温ベーク
- 対応可能な材料:薄膜・厚膜・ネガポジ両用レジスト、誘電体、カラーレジスト、接着剤、ポリイミドなど
- マルチユーザーコンセプトのGUI
- スマートプロセス制御とデータ解析 機能[EVG CIMFramework]